

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60249-2-15

Première édition
First edition
1987-10

Matériaux de base pour circuits imprimés

Deuxième partie: Spécifications

Spécification n° 15: Film flexible de polyimide
recouvert de cuivre, d'inflammabilité définie

Base materials for printed circuits

Part 2: Specifications

Specification No. 15: Flexible copper-clad
polyimide film, of defined flammability



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60249-2-15: 1987

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- **«Site web» de la CEI***
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement
(Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60249-2-15

Première édition
First edition
1987-10

Matériaux de base pour circuits imprimés

Deuxième partie: Spécifications

Spécification n° 15: Film flexible de polyimide
recouvert de cuivre, d'inflammabilité définie

Base materials for printed circuits

Part 2: Specifications

Specification No. 15: Flexible copper-clad
polyimide film, of defined flammability

© IEC 1987 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun
procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo-
copie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission in
writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

L

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
Articles	
1. Domaine d'application	6
2. Matériaux et construction	6
3. Marquage interne	8
4. Propriétés électriques	8
5. Propriétés non électriques du film recouvert de cuivre	10
6. Propriétés non électriques du matériau de base après enlèvement complet de la feuille de cuivre	18
7. Emballage et marquage	20
8. Essais de réception	20
9. Exigences supplémentaires	20

Withdrawing

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
Clause	
1. Scope	7
2. Materials and construction	7
3. Internal marking	9
4. Electrical properties	9
5. Non-electrical properties of the copper-clad film	11
6. Non-electrical properties of the base material after complete removal of the copper foil	19
7. Packaging and marking	21
8. Acceptance testing	21
9. Additional requirements	21

Withdrawn

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATÉRIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMÉS**Deuxième partie: Spécifications****Spécification n° 15: Film flexible de polyimide recouvert de cuivre,
d'inflammabilité définie****PRÉAMBULE**

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 52 de la CEI: Circuits imprimés.

La présente norme constitue la Spécification n° 15 d'une série de publications, laquelle remplacera les spécifications comprises à l'origine dans la Publication 249-2 de la CEI et pourra aussi inclure de nouvelles spécifications.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote	Procédure des Deux Mois	Rapport de vote
52(BC)245	52(BC)274	52(BC)263	52(BC)291

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

- Publications nos 249-1 (1982): Matériaux de base pour circuits imprimés, Première partie: Méthodes d'essai.
 249-3A (1976): Premier complément à la Publication 249-3 (1973): Matériaux de base pour circuits imprimés. Troisième partie: Matériaux spéciaux utilisés en association avec les circuits imprimés — Spécification n° 2: Spécification pour feuille de cuivre utilisée pour la fabrication de matériaux de base plaqués cuivre.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS
Part 2: Specifications
Specification No. 15: Flexible copper-clad polyimide film,
of defined flammability

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.
- 4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an item of equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 52: Printed Circuits.

This standard forms Specification No. 15 of a publication series which will replace the specifications originally included in IEC Publication 249-2 and will also include new specifications.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting	Two Months' Procedure	Report on Voting
52(CO)245	52(CO)274	52(CO)263	52(CO)291

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Reports indicated in the above table.

The following IEC publications are quoted in this standard:

- Publications Nos. 249-1 (1982): Base materials for printed circuits, Part 1: Test methods.
249-3A (1976): First supplement to Publication 249-3 (1973): Base materials for printed circuits, Part 3: Special materials used in connection with printed circuits -- Specification No. 2: Specification for copper foil for use in the manufacture of copper-clad base materials.

MATÉRIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMÉS

Deuxième partie: Spécifications

Spécification n° 15: Film flexible de polyimide recouvert de cuivre, d'inflammabilité définie

1. Domaine d'application

Cette spécification donne les exigences concernant les propriétés des films flexibles de polyimide recouverts de cuivre, d'inflammabilité définie.

Note. — Pour désigner ce matériau, on peut utiliser la référence 249-2-15-IEC-PI-Cu; s'il n'y a pas de confusion possible, on peut utiliser aussi la désignation plus brève IEC-249-2-15.

Cette spécification comporte des exigences facultatives qui s'appliquent uniquement par accord entre acheteur et fournisseur. Les films cuivrés répondant à toutes les exigences des essais non marqués «facultatif» sont considérés comme conformes à cette spécification.

2. Matériaux et construction

Le matériau consiste en un film isolant flexible recouvert d'une feuille de cuivre sur une face ou sur les deux faces, avec ou sans emploi de colle. Cette spécification ne concerne pas les laminés de polyimide avec d'autres films (par exemple [éthylène/propylène] perfluoré, FEP, ou polytétrafluoréthylène, PTFE).

2.1 Base isolante

Sa résistance à la flamme est définie par les exigences d'inflammabilité du paragraphe 6.3.

2.1.1 Film de polyimide

Film de polyimide dont les épaisseurs préférentielles et les tolérances sont données dans le tableau ci-dessous (mesures effectuées suivant la méthode du paragraphe 3.14 de la Publication 249-1 de la CEI). D'autres épaisseurs peuvent être utilisées après accord entre acheteur et fournisseur.

TABLEAU I

Épaisseurs préférentielles et tolérances admissibles pour le film de polyimide

Épaisseur nominale		Tolérance maximale admissible en un point quelconque
µm	in	%
12,5	0,0005	±30
25	0,001	±20
50	0,002	±15
75	0,003	±10
125	0,005	±10

2.1.2 Agent de liaison

Une couche de colle peut être utilisée entre le film de polyimide et la feuille métallique.

2.2 Feuille de métal

Cuivre répondant à la Publication 249-3A de la CEI.

BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS

Part 2: Specifications

Specification No. 15: Flexible copper-clad polyimide film, of defined flammability

1. Scope

This specification gives requirements for properties of flexible copper-clad polyimide film, of defined flammability.

Note. — To designate this material, the reference 249-2-15-IEC-PI-Cu may be used, if there is no risk of confusion, the type designation may be abbreviated to read IEC-249-2-15.

The specification includes optional requirements which apply only by agreement between purchaser and supplier. Copper-clad film complying with all the requirements not marked “optional” should be deemed to comply with this specification.

2. Materials and construction

The material consists of an insulating flexible film base with copper foil bonded to one or both sides, with or without the use of an adhesive. This specification does not cover laminates of polyimide with other films (e.g. perfluoro [ethylene/propylene], FEP, or polytetrafluoroethylene, PTFE).

2.1 Insulating base

Its flame resistance is defined in terms of the flammability requirements of Sub-clause 6.3.

2.1.1 Polyimide film

Polyimide film of preferred thicknesses and permitted tolerances as given in the following table when measured by the method of Sub-clause 3.14 of IEC Publication 249-1. Other thicknesses may be used by agreement between purchaser and supplier.

TABLE I

*Preferred thicknesses and permitted tolerances of
polyimide film*

Nominal thickness		Maximum permitted tolerance at any point
μm	in	%
12.5	0.0005	±30
25	0.001	±20
50	0.002	±15
75	0.003	±10
125	0.005	±10

2.1.2 Bonding medium

A layer of adhesive may be used between the polyimide film and the metal foil.

2.2 Metal foil

Copper as specified in IEC Publication 249-3A.